

◆ 用途 – Application –

- 電源回路、モーター等
- For power circuit, motor etc.

◆ 特長 – Features –

- 従来 6332 サイズで 2W を保証。抵抗温度特性は  $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$  以内
- 耐熱、耐侯性に優れるメタルグレース系抵抗膜、グレース系保護膜を採用
- 放熱性に優れる材料・構造で温度上昇を小さくしています。
- RoHS 対応品
- Rated power of 2W instead of 1W assured at the size 2512. TCR within  $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$  available.
- Introducing of both metal glazed resistive film and glazed protective coating allows to resist in heat and in weather ability.
- Keep the temp. increase small due to the heat release material and structure.
- RoHS compliant product.

◆ 構造・寸法 – Construction・Dimensions –

形名 Type	Inch size	寸法 Dimensions: mm					包装数量 /Qty
		L	W	t	a	b	
CPR63	2512	6.30±0.20	3.20±0.20	0.60±0.10	0.70±0.20	2.20±0.20	4,000

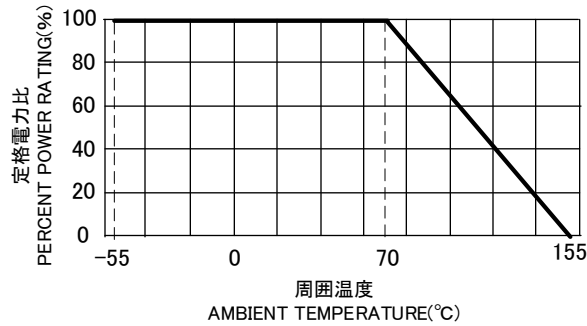
◆ 仕様 – Specifications –

形名 Type	Inch size	定格電力 Power Rating	最高使用電圧 Max. Working Voltage	最高過負荷電圧 Max. Overload Voltage	抵抗温度係数 T.C.R. ppm/°C	抵抗値範囲 Resistance Range			使用温度範囲 Operating Temp. Range
						±1% E96, E24	±2% E24	±5% E24	
CPR63	2512	2.0W	200V	400V	±100	0.1–1MΩ	0.1–1MΩ	0.1–1MΩ	-55°C~+155°C

◆ 形名 – How to Code –

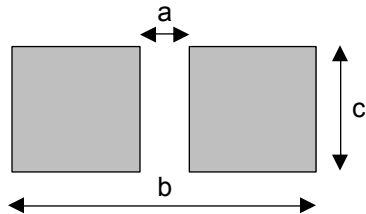
<b>CPR</b>	<b>63</b>	<b>TR</b>	<b>103</b>	<b>F</b>
種類 Type	定格電力 Power Rating	包装形態 Package	抵抗値 Resistance Value	許容差 Tolerance
	63 2.0W	TR Reel	E24(J,G) 3digits E96(F) 4digits 例) Ex. 10Ω→100 49.9Ω→49R9	J ±5% G ±2% F ±1%

## ◆ 負荷電力軽減曲線 - Power Derating Curve -



## ◆ 使用上の注意 - Usage Note -

### ■ 推奨ランドパターン -Recommended Solder Pad Dimensions-



パターン寸法(mm) Solder Pad Dimensions (mm)		
a	b	C
2.0	8.0	3.2

この製品は高電力タイプのチップ抵抗の為、チップの発熱/放熱に対する注意が特に必要です。

発熱/放熱は使用される基板(面積、積層数など)やランドパターンに依存します。下記の温度上昇データを参考としてください。

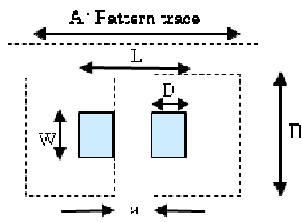
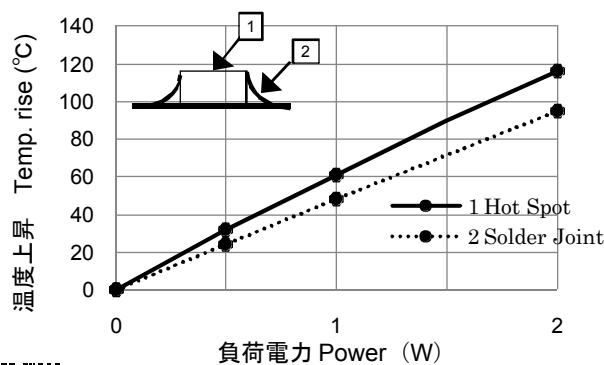
チップの発熱が実装基板や周辺部品への影響、問題ないことを事前に確認の上ご使用ください。

This chip resistor is High power chip type resistors, in use of it, it is necessary to take care in use for heat-generating and radiation.

Heat-generating and radiation are depend on the solder pad for a PCB board (square measure, number of layers etc)

Please refer as follow temperature rise data. When use this chip resistor, please confirm influence and trouble by heat-generating to mounted board and around products in advance.

### ■ 温度上昇 -Temperature Rise-



パターン寸法(mm) Solder Pad Dimensions				
a	B	L Total Length	W Total width	D Pad Depth
2.00	15.00	8.00	3.50	3.00

ガラスエポキシ基板 (t=1.6mm) Cu 箔 35μm

Glass epoxy board (t=1.6mm) Copper foil 35μm